



2022年10月14日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

**半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による  
設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ**

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社である寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司（以下、「FTNC」）における生産能力増強を目的とした設備投資（固定資産の取得）に関する決議を行いましたので下記の通りお知らせします。

記

**1. 設備投資の概要**

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| (1) | 投資予定金額            | 約530百万中国元（約108億円） ※1中国元=20.39円  |
| (2) | 主な設備の内容           | ① 銀川地区 既存工場（第1工場）の能力増強<br>-石英坩堝：大口径製品用の溶融機の増設、自動化設備等<br>② 銀川地区 新工場（第2工場）建設<br>-敷地総面積：約27,300㎡<br>-建屋総面積：約33,200㎡<br>-製造設備（シリコンパーツ、石英坩堝）、研究設備等 |
| (3) | 資金調達方法            | 自己資金および借入による  |
| (4) | 新工場（第2工場）建設スケジュール | 着 工： 2022年10月<br>建 屋 完 成： 2023年8月（予定）<br>設備納入・調整： 2023年9月（予定）<br>生 産 開 始： 2023年10月（予定）  |

**2. 投資の背景**

- FTNC における石英坩堝事業は専ら銀川地区の工場で生産しておりますが、対象市場である半導体市場及び太陽電池市場からの引合いが強く、今後もその傾向が続くと見込み生産能力増強を決定致しました。既存工場（第1工場）は小口径から大口径までの幅広い製品に対応できる能力を有しますが、今後需要の伸びが期待できる大口径製品用の能力を増強するべく、既存工場と新工場（第2工場）双方で投資を行います。
- シリコンパーツ事業については、旺盛な需要を背景に2022年5月17日付開示「半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資（第三回）に関するお知らせ」で申し上げた通り、銀川、杭州に続く3拠点目の常山工場の建設を進めておりますが、既存の銀川工場でも能力増強を図ります。従来よりも生産品目を増やし、顧客層の更なる拡大を図ります。
- また、今回新工場（第2工場）の中に、新たに技術研究センターを設け、研究・開発能力向上を図ることで会社の持続的な発展に努めてまいります。

### 3. FTNCの概要 (2022年9月30日現在)

|     |                 |  |                                     |
|-----|-----------------|--|-------------------------------------|
| (1) | 名 称             | 寧夏盾源聚芯半導體科技股份有限公司 (FTNC)                 |                                     |
| (2) | 所 在 地           | 中国寧夏回族自治区銀川市西夏区經濟技術開發区光明西路 23 号          |                                     |
| (3) | 代表者の役職・氏名       | 董事長 賀 賢漢                                 |                                     |
| (4) | 事 業 内 容         | 半導體製造用部材 (石英坩堝、シリコンパーツ) 製造・販売            |                                     |
| (5) | 資 本 金           | 187,144 千中国元 (約 38 億円) ※ 1 中国元=20.39 円   |                                     |
| (6) | 設 立 年 月 日       | 2011 年 4 月 20 日                          |                                     |
| (7) | 大株主及び持ち分比率      | 杭州大和熱磁電子有限公司 (FTH、当社 100%連結子会社) : 60.13% |                                     |
| (8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資 本 関 係                                  | 当社連結子会社である FTH が議決権の 60.13%を保有する子会社 |
|     |                 | 人 的 関 係                                  | 当社の取締役 1 名が同社の董事を兼任                 |
|     |                 | 取 引 関 係                                  | 該当事項はありません                          |

### 4. 今後の予定と見通し

本件が当社の今期連結業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。

以 上